



## 平成 30 年5月期 第 3 四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成 30 年3月 30 日

上場会社名 三益半導体工業株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 8155 URL <http://www.mimasu.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 細谷 信明  
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部担当 (氏名) 八高 達郎 (TEL) 027-372-2011  
 四半期報告書提出予定日 平成 30 年4月 13 日 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成 30 年5月期第3四半期の業績(平成 29 年6月 1 日～平成 30 年2月 28 日)

#### (1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30 年5月期第3四半期	54,416	18.8	3,642	22.4	3,648	24.9	2,466	24.8
29 年5月期第3四半期	45,786	11.3	2,976	2.6	2,919	5.8	1,975	3.9

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
30 年5月期第3四半期	76.77	—
29 年5月期第3四半期	61.49	—

#### (2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
30 年5月期第3四半期	91,391	57,312	62.7
29 年5月期	79,574	55,637	69.9

(参考)自己資本 30 年5月期第3四半期 57,312 百万円 29 年5月期 55,637 百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
29 年5月期	—	13.00	—	13.00	26.00
30 年5月期	—	14.00	—	—	—
30 年5月期(予想)	—	—	—	14.00	28.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 平成 30 年5月期の業績予想(平成 29 年6月 1 日～平成 30 年5月 31 日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通 期	72,500	20.3	4,430	20.0	4,370	20.0	2,950	20.5	91.82

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

30年5月期3Q	35,497,183株	29年5月期	35,497,183株
----------	-------------	--------	-------------

② 期末自己株式数

30年5月期3Q	3,369,147株	29年5月期	3,368,610株
----------	------------	--------	------------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

30年5月期3Q	32,128,387株	29年5月期3Q	32,128,716株
----------	-------------	----------	-------------

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】2ページ「(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する説明 .....	2
(2) 財政状態に関する説明 .....	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	2
2. 四半期財務諸表及び主な注記 .....	3
(1) 四半期貸借対照表 .....	3
(2) 四半期損益計算書 .....	5
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項 .....	6
(継続企業の前提に関する注記) .....	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	6
(セグメント情報) .....	6

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費が持ち直すなど、緩やかな回復が継続いたしました。

半導体シリコンウエハは、旺盛なメモリデバイス需要に牽引されて、生産は引き続き高水準で推移いたしました。また、当社の主要なユーザーである半導体・電子部品関連各社の設備投資にも活発な動きが見られました。

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。

この結果、当第3四半期累計期間の売上高は544億1千6百万円と前年同四半期比18.8%の増収となり、営業利益は36億4千2百万円(前年同四半期比22.4%増)、経常利益は36億4千8百万円(同24.9%増)、四半期純利益は24億6千6百万円(同24.8%増)となりました。

半導体事業部

当事業部におきましては、旺盛な半導体需要に支えられ、主力の300mmウエハを中心に高水準の生産を継続いたしました。そうした中で、更なる生産性の向上と原価低減を推進いたしました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。この結果、自社開発製品及びその他の取扱商品ともに増収となりました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

## (2) 財政状態に関する説明

当第3四半期会計期間末における総資産は、売上債権の増加等により、前事業年度末と比較して118億1千6百万円増加し、913億9千1百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の増加等により101億4千1百万円増加し、340億7千9百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加15億9千8百万円等により、573億1千2百万円となりました。

## (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成29年12月26日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました業績予想に変更はございません。

## 2. 四半期財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成29年5月31日)	当第3四半期会計期間 (平成30年2月28日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	26,742	22,259
受取手形及び売掛金	20,512	28,943
商品及び製品	776	261
仕掛品	443	772
原材料及び貯蔵品	1,573	1,683
その他	1,660	1,544
貸倒引当金	△8	△4
流動資産合計	51,699	55,460
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	10,598	16,481
その他(純額)	15,032	16,972
有形固定資産合計	25,631	33,453
無形固定資産	555	493
投資その他の資産		
その他	1,693	1,991
貸倒引当金	△5	△5
投資その他の資産合計	1,687	1,985
固定資産合計	27,875	35,931
資産合計	79,574	91,391
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	14,604	19,135
短期借入金	100	100
未払法人税等	970	767
引当金	62	457
その他	5,453	11,097
流動負債合計	21,190	31,558
固定負債		
長期借入金	300	225
退職給付引当金	1,439	1,366
その他	1,007	929
固定負債合計	2,746	2,520
負債合計	23,937	34,079

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成29年5月31日)	当第3四半期会計期間 (平成30年2月28日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	22,690	24,289
自己株式	△4,762	△4,763
株主資本合計	55,530	57,128
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	102	169
繰延ヘッジ損益	5	15
評価・換算差額等合計	107	184
純資産合計	55,637	57,312
負債純資産合計	79,574	91,391

(2) 四半期損益計算書  
(第3四半期累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自平成28年6月1日 至平成29年2月28日)	当第3四半期累計期間 (自平成29年6月1日 至平成30年2月28日)
売上高	45,786	54,416
売上原価	40,591	47,617
売上総利益	5,195	6,799
販売費及び一般管理費	2,219	3,156
営業利益	2,976	3,642
営業外収益		
受取利息	3	2
受取配当金	8	7
その他	23	44
営業外収益合計	34	54
営業外費用		
支払利息	0	0
為替差損	89	28
その他	0	19
営業外費用合計	90	48
経常利益	2,919	3,648
特別利益		
固定資産売却益	17	16
受取保険金	38	—
特別利益合計	55	16
特別損失		
固定資産除売却損	18	56
減損損失	11	—
その他	49	—
特別損失合計	79	56
税引前四半期純利益	2,896	3,607
法人税、住民税及び事業税	804	1,225
法人税等調整額	116	△83
法人税等合計	920	1,141
四半期純利益	1,975	2,466

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

報告セグメントごとの売上高に関する情報  
前第3四半期累計期間 (自 平成28年6月1日 至 平成29年2月28日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	18,135	27,651	—	45,786	—	45,786
セグメント間の内部売上高 又は振替高	3	—	1,907	1,910	△1,910	—
合計	18,139	27,651	1,907	47,697	△1,910	45,786

当第3四半期累計期間 (自 平成29年6月1日 至 平成30年2月28日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	23,143	31,273	—	54,416	—	54,416
セグメント間の内部売上高 又は振替高	16	—	3,543	3,560	△3,560	—
合計	23,159	31,273	3,543	57,976	△3,560	54,416